

Автоматическое оборудование для удаления припоя и исправления дефектов пайки компонентов BGA ASE2500L



Производитель:

Цена:

Описание

Полностью автоматическое встроенное в линию оборудование для удаления припоя/исправления дефектов пайки компонентов BGA/пайки. Подходит для ремонта дефектных изделий в процессе сборки полупроводниковых кристаллов, используется одноточечная лазерная система. В системе исправления дефектов пайки компонентов BGA и пайки применяется человеко-машинное управление, интеллектуальная система движения. Можно хранить несколько наборов программ с рецептами обработки изделия. Возможна простая и быстрая перенастройка линии на другое изделие. Стандартная загрузка и выгрузка компонентов SMT, регулируемые компоненты на зубчатой ленте с ESD можно подключить к другому технологическому оборудованию выше или ниже в производственной линии. Обеспечена общая высокая совместимость и совместим со стандартными в отрасли лотками BGA.

Бесконтактное одноточечное удаление припоя

Используется бесконтактная головка для удаления припоя в одной точке. С помощью высокоточного лазерного датчика измерения высоты и прецизионного датчика веса удаление припоя в одной точке может эффективно устранять дефекты изделий в одной точке без необходимости удаления припоя на всей детали. Это повышает эффективность удаления припоя, сокращает объем отходов, снижает риск повреждения BGA и брака при удалении припоя.

Бесконтактное одноточечное удаление припоя

Image not found or type unknown

Система исправления одноточечных дефектов пайки компонентов BGA и лазерной пайки

Четыре набора независимых игл используются для одноточечного переноса флюса из флюсовой системы на монтажные площадки.

Четыре набора независимых присосок наносят шарики припоя на контактные площадки, которые затем затвердевают с помощью лазерной пайки.

Три комплекта системы визуализации CCD

Оснащено тремя комплектами систем технического зрения CCD и используется программное обеспечение собственной разработки для обнаружения материалов в лотке и их точной загрузки и выгрузки. AOI обнаруживает и точно определяет местоположение дефектов на изделии. После смены линии сопло для исправления дефектов пайки компонентов BGA автоматически калибруется.

Четыре комплекта независимых платформ предварительного нагрева

Предусмотрено четыре набора независимых платформ предварительного нагрева. Платформа предварительного нагрева оснащена системой нагрева и контроля температуры. На платформе предварительного нагрева осуществляются удаление припоя и исправление дефектов пайки компонентов BGA. Как платформа предварительного нагрева, так и головка для удаления припоя используют замкнутый контур контроля температуры. Общий контроль температуры является стабильным и точным.

Параметры изделия

Модель №	ASE2500L
Общая мощность	5 кВт
Допустимые размеры BGA	27x27 мм (макс.); 3x3 мм (мин.)
Размеры лотка	323x136x8 мм (стандартный в отрасли лоток)
Температура предварительного нагрева	≤200 °C (регулируемая)
Температура нагревателя головки для снятия припоя	≤600 °C (регулируемая)
Остатки после удаления припоя	<15%
Насадка для удаления припоя	Ø0,2-1, с возможностью замены
Размер шарика	0,2-0,76 мм
Отклонение точности исправления дефектов пайки компонентов BGA	<1/3 диаметра шарика
Насадка для исправления дефектов пайки компонентов BGA	Ø0,15-0,6, с возможностью замены
Производительность	Производительность свыше 95%

Время перенастройки линии на другое изделие	30 мин
Калибровка после замены насадки для исправления дефектов пайки компонентов BGA	Калибровка датчиков CCD + устройства для размерной настройки инструментов
Габариты	Длина 1420 x ширина 1280 x высота 1850 мм
Масса	1200 кг